

# はんだ・微細接合部会 シンポジウム

～地球にやさしい電子実装技術～生物多様性保全に貢献する実装技術

開催期日：平成22年8月31日（火）

開催場所：化学会館 ホール（7階）（東京 御茶ノ水）

開催趣旨：本年2010年は、国連が定める「国際生物多様性年」であることから、「生物多様性」が世界的にも注目されています。「生物多様性」とは、文字通り地球上の多種多様な生き物のつながりを意味するものです。その生物多様性が、現在人間活動により危機に曝されており、その一因として、化学物質による大気や水の汚染、地球温暖化に伴う環境変化などが挙げられています。実装技術においても生物多様性に負荷を与えない生産方式が注目されています。そこで、今回は地球環境に優しい製品および技術に関する講演を企画させていただきました。生物多様性保全に実装技術はどのように貢献できるのか、地球環境に優しい製品・技術開発の一助となることを期待しております。皆様のご参加を心からお待ち申し上げます。

主催：社団法人 日本溶接協会 はんだ・微細接合部会 技術委員会 微細接合技術分科会

協賛：社団法人 エレクトロニクス実装学会 電子部品・実装技術委員会／先進実装技術研究会

後援：社団法人 電子情報技術産業協会

## 【参加申込方法】

申込書（コピー可）に必要事項を記入し、下記申込先に郵送またはファックスでお送り下さい。受付後、折り返し参加証をファックスで送付いたしますので、シンポジウム当日は必ず参加証をお持ち下さい。

参加定員：定員100名（定員になり次第締め切ります。）

参加費用：（会員）12,000円、（非会員）18,000円／1名（資料代および消費税を含む）

※振込手数料は、各自ご負担下さい。

※会員とは、日本溶接協会 本部団体会員 (<http://www-it.jwes.or.jp/kain/kaindsp.jsp>) およびエレクトロニクス実装学会会員 (<http://www.e-jisso.jp/support/index.html>) です。

※日本溶接協会 はんだ・微細接合部会 部会員およびエレクトロニクス実装学会 電子部品・実装技術委員会委員の参加費用につきましては、別途各社委員へお問合せ下さい。

振込先：三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 No.146921（社）日本溶接協会

※参加費用は上記の口座にご送金下さい。また、納入された参加費は返却致しかねますのでご了承下さい。銀行口座への振込をもって領収にかえさせていただきます。

なお、参加費用の振り込みが、シンポジウム当日以後になる場合は、必ず申込書に振込予定日をご記入下さい。

お申込先：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11 （社）日本溶接協会

担当：木口明浩 TEL：03-3257-1524 FAX：03-3255-5196

## 【プログラム内容】

午前の部：

座長：ソニー（株）荒金 秀幸 氏

10:00-10:05 開会挨拶 千住金属工業(株)鶴田 加一氏 (日本溶接協会 はんだ・微細接合部会 幹事長)

10:05-10:40 「高効率多結晶シリコン太陽電池の開発」

三菱電機（株）森川 浩昭 氏

10:40-11:15 「Ag 焼成電極上へのレーザはんだ付性評価」

シャープ（株）谷口 仁啓 氏

11:15-11:50 「太陽光発電モジュールにおける接合事例」

日本アビオニクス（株）大口 達也 氏

11:50-13:00

昼 食・休 憩

午後の部(パート1)：

座長：(株)村田製作所 高岡 英清 氏

13:00-13:35 「両面放熱パワーモジュール用 Pb フリーはんだ材料」

(株)デンソー 坂本 善次 氏

13:35-14:10 「IGBT モジュール用超音波接合技術」

富士電機システムズ（株）木戸 和優 氏

14:10-14:45 「高放熱基板の開発状況」

日本シイエムケイ（株）須川 孝善 氏

14:45-15:00

休 憩

午後の部(パート2)：

座長： 実装技術 NPO 法人 サーキットネットワーク 本多 進 氏

15:00-15:35 「AlN 材料によるパワーチップの効率的な放熱技術動向」

(株) トクヤマ 金近 幸博 氏

15:35-16:10 「低温焼結性高耐熱性銀ナノペースト」

DOWA エレクトロニクス（株）遠藤 圭一 氏

16:10-16:45 「ワイヤー埋め込み基板」

第一実業（株）池田 博昌 氏

16:45-16:50 閉会挨拶 TDK(株)土門 孝彰氏(エレクトロニクス実装学会 電子部品実装技術委員会委員長)

シンポジウム企画：(社)日本溶接協会はんだ・微細接合部会微細接合技術分科会、

(社)エレクトロニクス実装学会・電子部品実装技術委員会先進実装技術研究会／電子部品技術研究会

